KOSDAQ | 반도체와반도체장비

# 텔레칩스 (054450)

## 다시 뛰는 차량용 반도체 전문기업

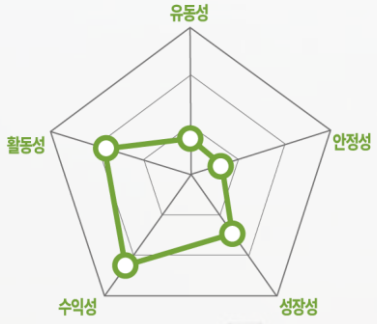
### 체크포인트

- 텔레칩스는 1999년 설립된 차량용 시스템 반도체 강소기업. 2025년 고객 수요 둔화와 연구개발인력 증가에 따른 비용 부담, 개발비 무형자산 손상차손 발생으로 실적은 저조했음. 그러나 SDV(소프트웨어 중심 차량), 자율주행 산업 성장 수혜와 고객다변화, 고부가 사업인 SoC 개발 용역 계약 체결(총 772억 원 규모, 25.10.10 공시)로 2026년 영업이익은 턴어라운드(흑자전환) 가시화 중
- 투자포인트는 1) SoC 개발 용역 계약 체결 통한 실적 턴어라운드, 2) 지속적인 고객 다변화
- 2026F 매출액, 영업이익 각각 2,405억 원(+24.7% YoY), 171억원(흑자전환 YoY) 전망. 연간 부문별 매출 비중 DMP 71.8%, 모바일TV 수신칩 0.6%, 기타 27.6% 전망. SoC 개발 용역 매출로 인해 기타 매출 전년 대비 큰 폭으로 증가 예상(+81.0% YoY)

### 주가 및 주요이벤트

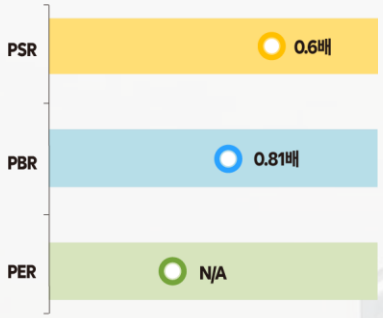



### 재무지표

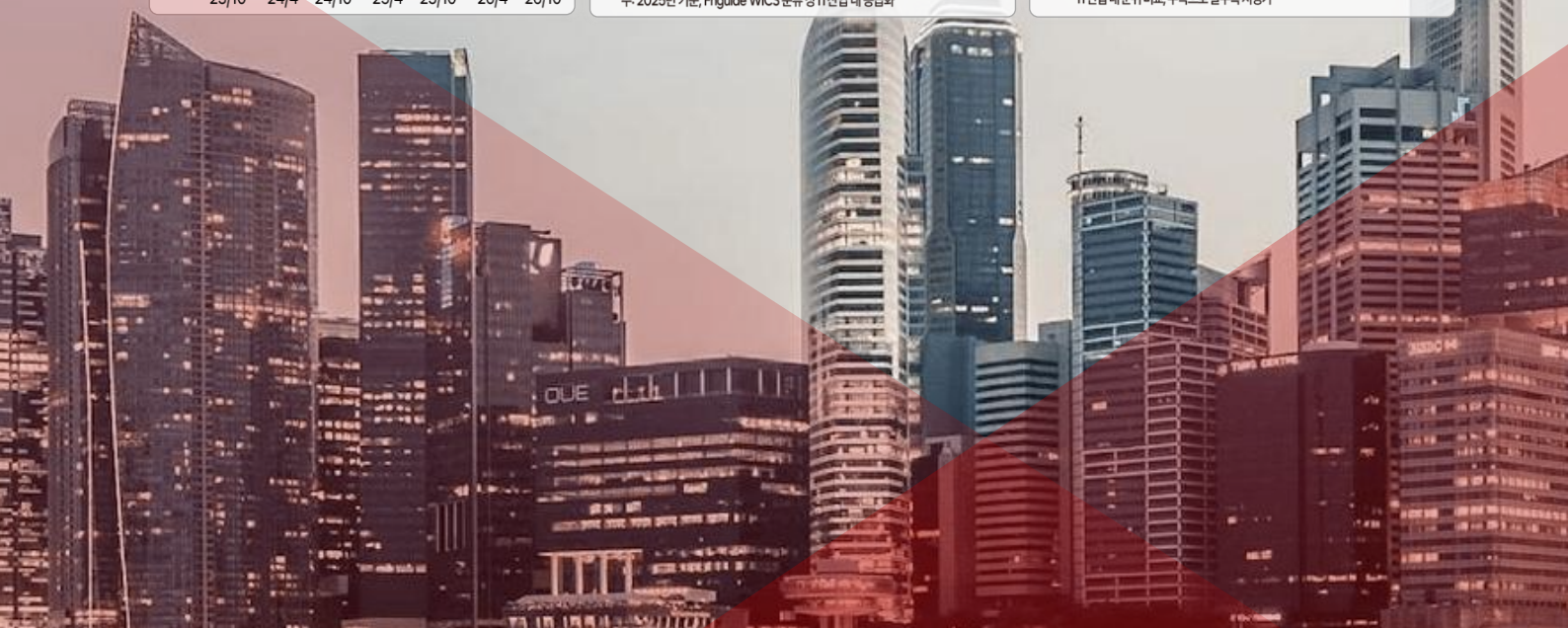



주: 2025년 기준, Fnguide WICS 분류 상 IT산업 내 등급화

### 밸류에이션 지표




주: PSR, PER은 2025년 기준, PBR은 2Q26 기준, Fnguide WICS 분류상 IT산업 내 순위 비교, 우측으로 갈수록 저평가



# 텔레칩스 (054450)

KOSDAQ

반도체와반도체장비

**Analyst 백종석** jongsukbaek@kirs.or.kr
**RA 김지은** jekim0216@kirs.or.kr

## 텔레칩스는 차량용 시스템 반도체 제조/판매 사업 영위

동사는 1999년 설립된 비메모리 반도체 팹리스(제조설비 없이 반도체 설계 사업만 영위) 기업. 설립 초기 텔레칩스는 전화기용 Caller ID 칩, MP3 플레이어용 멀티미디어칩을 제조, 이후 차량 IVI(In Vehicle Infotainment)용 AP(Application Processor) 사업에 집중. 1H26 기준 부문별 매출 비중은 DMP(디지털 미디어 프로세서, 디지털 미디어 기기에 적용되는 각종 프로세서) 70.89%, 모바일TV 수신칩 0.84%, 기타 28.27%

## 글로벌 차량용 반도체 시장은 2025~2030년 기간 연평균 11.4% 성장 전망

차량용 반도체는 완성차 기업의 전동화 기술 경쟁력을 좌우하는 핵심 부품. 글로벌 차량용 반도체 시장은 2025년 약 774억 달러에서 2030년까지 연평균 11.4%로 성장할 전망. 글로벌 자동차 산업은 SDV(소프트웨어 중심 차량), 자율주행 중심으로 재편되고 있으며, 이에 따라 차량용 반도체 시장의 중장기 구조적 성장 이어질 전망

## 성장통 딛고 2026년 실적 개선 기대

2025년 연간 연결 매출액, 영업이익은 각각 1,928억 원(+3.3% YoY), -62억 원(적자전환 YoY)을 기록. 일부 고객 수요 감소, 연구개발인력 증가에 따른 비용 부담이 주로 작용. 2026년 연간 매출액, 영업이익은 각각 2,405억 원(+24.7% YoY), 171억 원(흑자전환 YoY)을 기대. 4Q25에 분기 흑자(영업이익 27억 원) 전환을 기록한 이후 1H26 실적 개선 흐름 시현 중. 고객 다변화가 지속되는 상황에서 대형 SoC 개발 용역 계약이 실적에 긍정적으로 작용. 향후 해외 수출 확대, SDV/자율주행 산업 성장 수혜 기대 가능

**Forecast earnings & Valuation**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026F |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 1,504 | 1,911 | 1,866 | 1,928 | 2,405 |
| YoY(%) | 10.3 | 27.1 | -2.3 | 3.3 | 24.7 |
| 영업이익(억원) | 92 | 168 | 49 | -62 | 171 |
| OP 마진(%) | 6.1 | 8.8 | 2.6 | -3.2 | 7.1 |
| 지배주주순이익(억원) | 459 | 626 | -386 | -616 | 58 |
| EPS(원) | 3,349 | 4,297 | -2,546 | -4,070 | 383 |
| YoY(%) | 543.3 | 28.3 | 적전 | 적지 | 흑전 |
| PER(배) | 3.3 | 7.7 | N/A | N/A | 18.4 |
| PSR(배) | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 0.4 |
| EV/EBITDA(배) | 8.1 | 16.9 | 16.3 | 102.3 | 7.5 |
| PBR(배) | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 0.7 |
| ROE(%) | 33.3 | 30.1 | -17.2 | -35.8 | 4.0 |
| 배당수익률(%) | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.4 |

자료: 한국IR협의회 기업리서치센터

**Company Data**

| | | |
|---|---|---|
| 현재주가(11/09) | | 7,060원 |
| 52주 최고가 | | 18,450원 |
| 52주 최저가 | | 7,060원 |
| KOSDAQ (11/09) | | 638.97p |
| 자본금 | | 76억원 |
| 시가총액 | | 1,069억원 |
| 액면가 | | 500원 |
| 발행주식수 | | 15백만주 |
| 일평균 거래량 (60일) | | 5만주 |
| 일평균 거래액 (60일) | | 5억원 |
| 외국인지분율 | | 2.50% |
| 주요주주 | 이장규 외 1 인 | 20.10% |
| | 엘엑스세미콘 | 10.00% |

**Price & Relative Performance**




**Stock Data**

| 주가수익률(%) | 1개월 | 6개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|
| 절대주가 | -30.5 | -57.7 | -43.9 |
| 상대주가 | -3.0 | -20.0 | -23.0 |

**참고**

1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '이자보상배율', 성장성 지표는 '매출액증가율', 수익성 지표는 '매출총이익률', 활동성지표는 '순운전자본회전율', 유동성지표는 '당좌비율'임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 밸류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음.

# 기업 개요

## 1 텔레칩스는 차량용 반도체 비메모리 팹리스 기업

**동사는 1999년 설립되어 2004년 코스닥 상장한 차량용 반도체 비메모리 팹리스 기업**

텔레칩스는 1999년 설립된 차량용 반도체 비메모리 팹리스 전문기업이다. 주요 제품 응용분야는 인텔리전트 오토모티브 솔루션(Intelligent Automotive Solution)이며, 동사는 차량 내 IVI(In Vehicle Infotainment)에 속하는 Car Audio, AVN(Audio/Video/Navigation) 반도체와 Digital Cluster(계기판), SVM(Surround View Monitoring), HUD(Head Up Display), RSE(Rear Seat Entertainment) 등에 들어가는 AP(Application Processor) 제품을 다양한 고객에게 공급하고 있다. 이밖에 모바일TV 수신칩, Connectivity 모듈, MCU(Micro Controller Unit, 특정 시스템을 제어하기 위한 전용 프로세서) 제품 등도 개발/공급하고 있다.

설립 초기 텔레칩스는 전화기용 Caller ID 칩과 MP3 플레이어용 멀티미디어칩을 제조/판매하며 성장했고, 2004년 12월 코스닥 시장에 상장하였다. 2007년 국내 최초로 카오디오용 AP 제품을 개발하여 완성차 고객에게 공급하였고, 2012년 안드로이드 OS(운영체제)용 스마트 미디어 플레이어 솔루션을 양산했다.
2013년 텔레칩스는 태블릿PC향 AP 제품의 재고 누적과 손실처리 영향으로 실적이 부진했었고(2013년 영업손실 -79억원 기록), 이때 모바일용 AP 사업을 구조조정했다. 이후 동사는 차량용 시스템 반도체 개발 및 공급 사업에 집중했다. 2015년 국내 최초로 자동차 AVN(Audio/Video/Navigation)용 AP 납품한 후 이를 확대·전개했다. 2019년에는 Cockpit(운전석) 시스템 칩을 공급하기 시작했고, 국내 최초로 디지털 클러스터 솔루션을 양산했다.

2020~2021년 코로나 팬데믹 기간 글로벌 완성차 수요가 견조한 상황에서 자동차용 원자재/부품은 공급 부족이 발생했고 차량용 부품, 특히 차량용 반도체 수급 문제는 전세계인들의 시선을 끄는 이슈가 되었다. 당시 텔레칩스는 2021년 국내 최초로 차량 인포테인먼트용 MCU(Micro Controller Unit) 제품을 출시, 자동차 업계의 높은 관심을 받았다.
텔레칩스는 2022, 2023년 기간 각각 연결 기준 매출액 1,504억 원(+10.3% YoY), 1,911억 원(+27.1% YoY)을 기록하며 견조한 실적을 보였다. 국내 고객 중심으로 동사 고부가 AP 수요가 견조했던 것에 기인했다. 한편 2022년 텔레칩스는 판교 제2테크노밸리로 본사를 이전, 장기적 성장을 위한 기반 시설·인프라를 갖추었다.

2024년 이후 텔레칩스는 실적 측면에서 성장통에 접어들었다. 산업 측면에서 전기차 산업에 캐즘(일시적 수요 정체)이 장기화되며 차량용 반도체 수요가 기대 대비 약해지고, 고객 측면에서 기존 주 고객 내에서 해외 경쟁사와의 경쟁 심화로 인해 주문이 일부 감소했다. 4Q24부터 대형 해외 고객(폭스바겐)향 매출이 발생하기 시작했지만, 기존 주 고객의 수요 하락을 완연히 상쇄하지는 못했고, 제품믹스 악화와 인건비 부담 상승 등으로 2025년 실적이 부진했다. 2025년 매출액, 영업이익은 각각 1,928억 원, -62억 원으로 전년 대비 매출액은 소폭 성장했으나 영업이익은 적자전환 했다.
그러나 일부 긍정적인 측면도 2025년 연중 발현되었다. 일본 차량, 오토바이 고객향으로 돌핀플러스 제품이 공급되기 시작했고, 대규모 SoC(System on a Chip) 개발 용역 계약이 체결되었다(총 772억 원 규모, 25.10.10 공시). 차량용 시스템 반도체 산업은 중소기업이 생존하기에 쉽지 않은 환경이지만, 텔레칩스는 오랜 업력과 기술력을 바탕으로 성장성과 수익성을 점차 개선시켜 나갈 것으로 기대된다.

**2026년 상반기 기준 연결대상 종속회사는 3개사, 지분법적용 대상 법인 1개사**

2026년 상반기 기준 동사 연결대상 종속회사는 3개사이다. 텔레칩스 홍콩(지분율 100%), 텔레칩스 상해(지분율 100%), 텔레칩스 심천(지분율 100%)이다.

그 외에 텔레칩스는 지분법적용 대상 법인으로 오토실리콘(어보브반도체와 합작한 합작사) 지분 31.28%를 보유하고 있다. 오토실리콘은 BMS(Battery Management System, 배터리 관리 시스템) 및 BMIC(배터리 관리 집적회로) 관련 칩과 시스템을 개발/양산한다.

**텔레칩스 연결대상 종속회사, 지분법적용 대상 법인 현황** (단위: 백만원, 주, %)

| 법인명 | 최초취득일자 | 기말잔액 | | | 최근사업연도 재무현황 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 |
| TELECHIPS HK LIMITED | 2004 년 04 월 30 일 | 2,000,000 | 100.00 | 87 | 95 | -1 |
| TELECHIPS SHANGHAI LIMITED | 2016 년 10 월 17 일 | - | 100.00 | 356 | 563 | 36 |
| TELECHIPS SHENZHEN LIMITED | 2019 년 04 월 15 일 | - | 100.00 | 343 | 391 | -6 |
| 주식회사 오토실리콘-보통주 | 2018 년 07 월 25 일 | 929,460 | 31.28 | - | 7,934 | -11,738 |

주: 1H26말 기준, 자료: Dart, 한국IR협의회 기업리서치센터

## 2 매출의 구성, 주요 제품/서비스

**매출 비중은 DMP가 70.89%로 주력**

텔레칩스 매출 비중을 살펴보면, DMP(디지털 미디어 프로세서, 디지털 미디어 기기에 적용되는 각종 프로세서) 70.89%, 모바일TV 수신칩 0.84%, 기타 28.27%로 구분된다(2026년 반기 사업보고서 기준). 구체적으로 텔레칩스의 DMP 주요 제품들을 살펴보면 다음과 같다.

**IVI용 AP는 주로 AVN용 AP 제품**

**✓IVI(In Vehicle Infotainment)용 AP**

주로 AVN(Audio/Video/Navigation)용 애플리케이션 프로세서(AP) 제품이다. 그 외에 디지털 클러스터(계기판) 및 HUD(Head Up Display), RSE(Rear Seat Entertainment)용 AP, Safety IC(안전관련 집적회로), PMIC(전원관리 집적회로), Broadcasting(방송수신) 칩 제품군도 있다.

대표적인 동사 제품은 'TCC897x', '돌핀플러스', '돌핀3' 제품이다. 성능이 향상된 '돌핀5' 제품은 개발 완료되어 소량 매출이 이루어지고 있다. 또 텔레칩스는 차기 제품인 '돌핀7' 제품을 연구개발하고 있다. 돌핀7은 개선된 성능과 고도화된 ADAS 기능 추가가 제품 차별화 요소이다. 이렇듯 동사는 지속적으로 성능을 개선한 신제품을 개발하고 있다.

**MCU는 차량 내 모터, 센서를 제어하는 역할**

**✓Automotive MCU(Micro Controller Unit)**

Automotive MCU는 차량 내에서 각종 모터, 센서 등을 제어하는 역할을 하는 시스템 반도체이다. 동사는 2021년 국내 최초로 차량 인포테인먼트용 MCU를 선보였고(제품명 VCP1), 바디/샷시용 MCU(제품명 VCP3) 개발을 완료했다.

향후 Zonal Architecture(영역별 설계) 구조로 차량 반도체 탑재 구조가 고도화될 시 VCP3와 같은 고부가 MCU 수요는 증가할 수 있을 것으로 전망된다. 참고로, 전동화 고도화 시 도래할 Zonal Architecture는 센트럴 게이트웨이 칩과 존별 게이트웨이 칩, ECU, MCU 등 차량 내 일정 영역 기능을 블록화하여 데이터 연산/제어/저장 등을 커버하는 체제이다.

**Gateway 칩셋은 네트워크 프로세서**

✓**Gateway 칩셋**

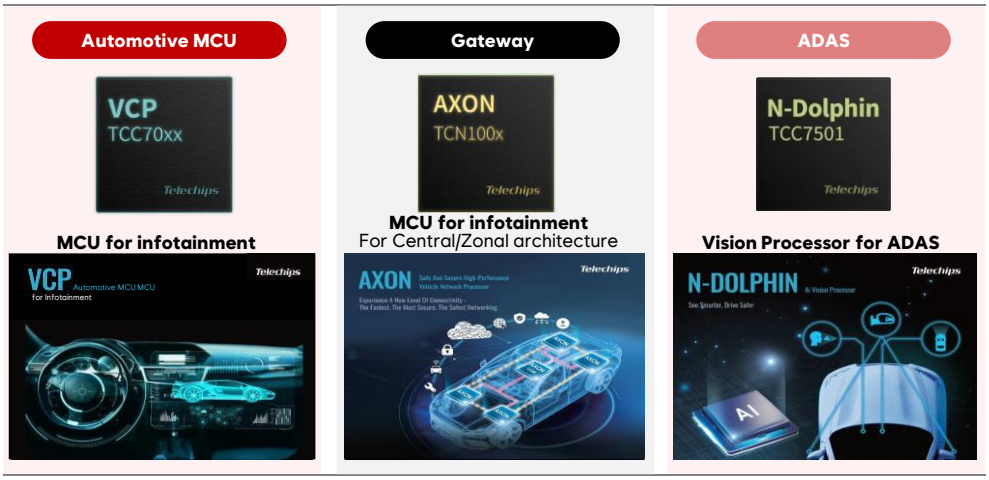
Gateway 칩셋은 차량용 네트워크 프로세서이다. 동사 관련 제품 브랜드는 'AXON'으로, 텔레칩스는 동 칩 개발을 2027년초 완료할 예정이다. 관련하여 제품 프로모션은 이미 사전에 진행 중이다. AXON은 OTA(무선 업데이트), 진단, 네트워크 관리 및 애플리케이션 통합을 지원한다. AXON은 차량 반도체 탑재 구조 상 Zonal 아키텍처 구조 도래 시 수요가 대량으로 증가할 것으로 기대된다. 높은 신뢰성과 고속 네트워킹을 제공하는 AXON은 9.5Gbps 4채널 이더넷(TSN 지원), 16채널 CAN, 8채널 LIN을 포함한 구성이며, 초저지연을 위한 하드웨어 엔진으로 구동된다.

**ADAS용 비전 프로세서는 스마트카 시대에 수요 증가 기대**

✓**ADAS(Advanced Driver Assistance Systems, 첨단 운전자 지원 시스템)용 프로세서**

'N-돌핀'은 ADAS용 비전 프로세서 제품이다. 스마트카로 차량이 점차 진화하면서 차량 내 각 부문에 비전 프로세서의 사용이 증가하고 있다. 따라서 중장기적으로 전사 매출 중에서 동 제품 매출 비중은 증가할 것으로 기대된다. 동사 브랜드 N-돌핀은 다기능 카메라(MFC), 운전자 모니터링 시스템(DMS), 실내 모니터링 시스템(IMS), 전자식 미러, ADAS 센서 모듈 등 핵심 기능을 단일 칩에 통합하여 차별화된 성능을 제공한다. 텔레칩스는 현재 동 제품 개발을 완료하고 프로모션 중이다.

Automotive MCU, Gateway 칩셋, ADAS 비전 프로세서




자료: 텔레칩스, 한국IR협의회 기업리서치센터

## 3 주 고객은 글로벌 완성차/부품 기업들

**주고객은 글로벌 완성차 및 전장부품 기업들**

텔레칩스 주 고객은 글로벌 완성차 및 전장부품 기업들이다. 2026년 연간 전망 기준 현대차/기아향 매출이 전사 매출 중 30~35%, 나머지 해외 고객군 및 기타향이 65~70% 비중으로 추정된다. 2024년 4분기부터 특정 해외 고객(독일 폭스바겐) 비중은 점차 증가하고 있다. 2025년 연간 전사 매출액 중 폭스바겐향 비중은 약 5%였고, 2026년에는 연간 5~10%대를 차지할 것으로 추정된다. 중장기적으로는 일본과 인도 고객 비중이 점진적으로 상승할 것으로 기대된다.

텔레칩스 주 고객




자료: 텔레칩스, 한국IR협의회 기업리서치센터

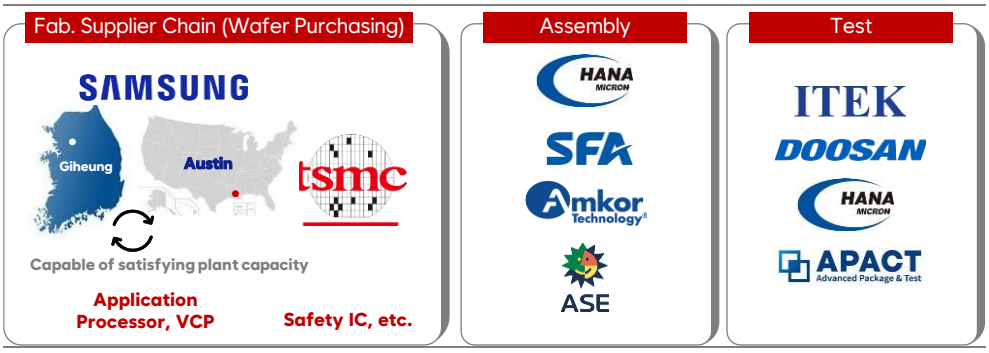
**동사는 NPU IP, EDA, DSP, OSAT, 파운드리 파트너들과 원활히 협업**

텔레칩스의 제조/판매 관련 파트너들과 협업 구조는 다음과 같다.

텔레칩스는 AP, MCU 등을 설계하고 삼성전자 파운드리 사업부에 제조를 위탁, 완성된 제품을 공급받고 있다. 설계 과정에서 NPU(Neural Processing Unit) IP(지적재산권) 전문기업들(사피온, 오픈엣지테크놀로지 등)과 협력하고, 글로벌 EDA(Electronic Design Automation) tool 및 IP를 보유한 기업들인 시놉시스, 케이던스와도 협업하고 있다. 또, 가온칩스와 같은 DSP(디자인 솔루션 파트너) 기업의 지원을 받아 칩을 완성하고 있다.

동사의 주력 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 업체들은 하나마이크론, Amkor, 아이텍, 두산테스나이다. OSAT 협력사들을 통해 텔레칩스는 칩의 최종 조립과 양품 테스트를 완료한다.

텔레칩스 글로벌 생산 생태계 현황




자료: 텔레칩스, 한국IR협의회 기업리서치센터

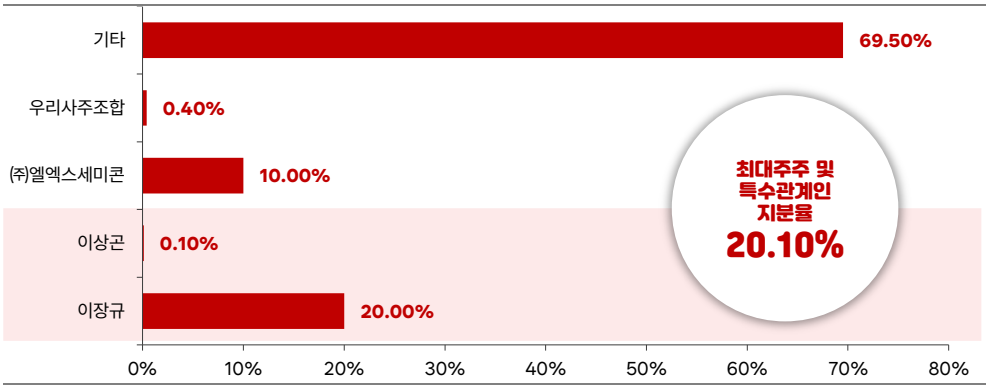
## 최대주주 등은 이장규 대표이사 외 1인

**1H26 기준 최대주주 및 특수관계인 지분의 합 20.10%**

텔레칩스의 최대주주는 이장규 대표이사로, 지분 20.0%를 보유 중이다. 최대주주 및 특수관계인은 이장규 대표이사 외 1인(이상곤 부사장)으로, 지분 20.10%를 보유하고 있다(2026년 반기 사업보고서 기준). 1963년생인 이장규 대표이사는 연세대학교 전자공학 석사 출신으로, 삼성전자 반도체 부문 연구원을 거친 이후 공동 창업자 서민호 전 대표이사와 함께 1999년 텔레칩스를 설립하였다. 서민호 전 대표이사가 경영에서 물러난 2013년 이후에는 이장규 대표이사가 단독 CEO로서 텔레칩스를 이끌고 있다.

한편 코스닥 상장사 LX세미콘은 현재 동사 지분 10.0%를 보유 중이다(2022년 5월에 투자). 디스플레이 시스템 반도체 제조/판매 팹리스 기업 LX세미콘은 전장 관련 시장에 대응하려는 목적 하에 동사에 투자를 한 것으로 보인다.

텔레칩스 주주 현황




주: 1H26말 기준, 자료: Dart, 한국IR협의회 기업리서치센터

# 산업 현황

## 1 글로벌 차량용 반도체 산업 현황

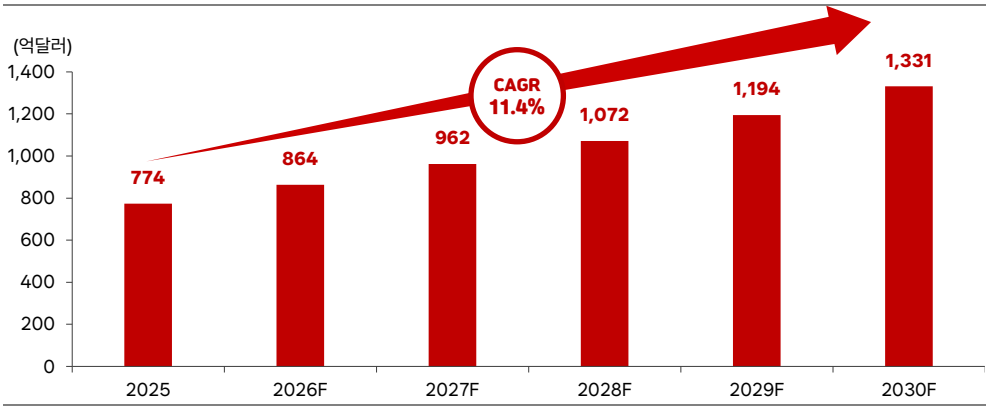
**글로벌 차량용 반도체 시장은 2025년 약 774억 달러 규모로, 2030년까지 연평균 11.4%로 성장할 전망**

차량용 반도체는 자동차 전장화 흐름 속에서 완성차 업체의 전동화 기술 경쟁력을 좌우하는 핵심 부품이다. 글로벌 자동차 산업은 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 중심으로 빠르게 재편되고 있으며, 이에 따라 차량용 반도체 시장의 중장기 구조적 성장도 이어질 전망이다. 자동차의 전기·전자 아키텍처 역시 기존 분산형 구조에서 존(Zonal) 및 중앙집중형 컴퓨팅 구조로 전환되고 있다. 이를 기반으로 무선 업데이트, 고도화된 인포테인먼트, ADAS(Advanced Driver Assistance Systems, 첨단 운전자 지원 시스템), 생성형 AI 기반 기능 등의 차량 탑재가 확대되는 추세이다. 글로벌 자동차 시장은 연평균 약 1.0% 성장에 그칠 것으로 예상되는 반면, 글로벌 자동차 소프트웨어 및 전장 시장은 연평균 4.5% 성장하여 2035년 약 5,190억 달러 규모에 이를 것으로 전망된다.

차량용 반도체는 이처럼 전장화된 자동차의 주행·제어 기능 전반을 전기적으로 구현하는 시스템 반도체로, 적용 범위와 기능에 따라 크게 MCU와 APU로 구분할 수 있다. 마이크로 컨트롤러 유닛(MCU, Micro-Controller Unit)은 파워트레인, 바디, ECU 등 차량 하드웨어 전반을 제어하는 반도체로, 온도, 압력, 속도 등 각종 물리 정보를 감지하는 센서부터 엔진, 트랜스미션, 구동장치 제어 등에 다양하게 사용된다. 애플리케이션 프로세서 유닛(APU, Application Processor Unit)은 ADAS, 인포테인먼트, 텔레매틱스 등 고도화된 전장 시스템에 주로 적용된다. ADAS가 주행 안전 기능을 담당한다면, IVI(In Vehicle Infotainment)와 텔레매틱스는 주행 편의성과 연결성 등을 높이는 역할을 한다. 이러한 기능들은 차량 콕핏(운전석)에 탑재되며, 최근에는 콕핏 아키텍처 역시 중앙집중화 흐름에 따라 단일 중앙 도메인 컨트롤러로 통합되는 추세이다.

결국 차량용 반도체는 인포테인먼트, ADAS, 자율주행, 차량 내 네트워크, 파워트레인 제어 등 자동차의 핵심 기능 전반에 사용되며, 시스템 고도화와 함께 그 중요성이 확대되고 있다. 시장조사기관 Mordor Intelligence에 따르면 글로벌 차량용 반도체 시장은 2025년 774억 달러에서 연평균 11.4% 성장하여 2030년 1,331억 달러 규모로 확대될 전망이다.

**글로벌 차량용 반도체 시장 규모 및 전망**




자료: Mordor Intelligence, 한국IR협의회 기업리서치센터

**차량용 반도체 시장은 인명과 안전에 직결된 핵심 부품으로 진입 장벽이 높음**

차량용 반도체 시장은 신규 업체가 단기간 내에 진입하기 어려운 일정한 진입장벽이 존재한다. 차량용 반도체는 센서, 엔진, 전자제어장치(ECU), 구동모터 등 차량 핵심 기능에 두루 적용되며, 인명 안전과 직결되는 특성상 일반 IT용 반도체 대비 훨씬 높은 수준의 신뢰성·내구성·품질 안정성이 요구된다. 제품 불량 발생 시 곧바로 큰 사고로 이어질 수도 있어 인증 절차가 매우 엄격하며, 제품 개발 착수부터 고객사 설계 반영, 양산에 이르기까지 수년이 소요되는 긴 개발/채택 사이클이 수반된다. 또한, 인포테인먼트 시스템의 고해상도 처리, ADAS 및 자율주행 시스템의 실시간 대용량 데이터 연산, AI 기반 기능 구현을 위한 고성능 컴퓨팅 역량까지 요구되어 제품에 대한 기술적 난이도가 높은 편이다. 종합하면, 차량용 반도체 시장은 높은 기술력뿐 아니라 장기간 고객사 레퍼런스도 요구된다고 볼 수 있다.

**차량용 VS 가정용, 산업용 반도체 간 요구 스펙 비교**

| | 차량용 | 가정용 | 산업용 |
|---|---|---|---|
| 온도 | -40°C~155°C | -10°C~70°C | 0°C~40°C |
| 필요 수명 | 15년 이상 | 1~3년 | 5~10년 |
| 습도 조건 | 0~100% | 낮음 | 75% 이하 |
| 허용 불량률 | 0% 목표 | 3% | 1% 미만 |
| 재고 보유 기간 | 30년 | 2년 | 5년 |

자료: 언론종합, 한국IR협의회 기업리서치센터

**글로벌 차량용 반도체 시장은 상위 업체 중심의 과점 구조가 형성**

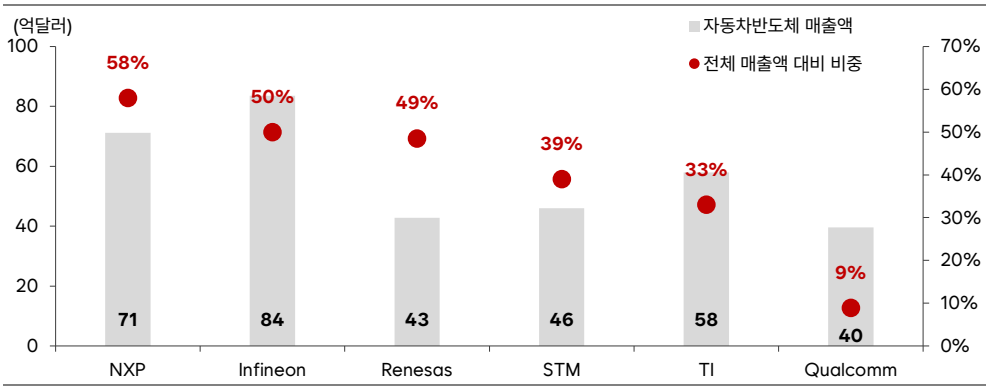
글로벌 차량용 반도체 시장은 상위 업체 중심의 과점 구조가 뚜렷하다. NXP Semiconductors(네덜란드), Infineon Technologies(독일), Renesas Electronics(일본) 등 주요 3개사를 포함한 매출 상위 10개 기업이 전체 글로벌 차량용 반도체 매출의 약 60%를 차지하고 있다. 주요 기업들은 대부분 설계와 생산을 함께 수행하는 IDM(종합 반도체 기업) 체제를 기반으로 사업을 영위 중이나, 제품군에 따라 일부 생산은 외부 파운드리에 위탁하기도 한다.

기업별로 보면, **NXP Semiconductors(네덜란드)**는 차량용 프로세서, 레이더 칩, 보안 커넥티비티 솔루션 분야의 핵심 공급업체로, ECU 통합과 전장 시스템 단순화를 통해 존 아키텍처 전환을 가속화하고 있다. **Infineon Technologies(독일)**는 전력반도체, 마이크로컨트롤러, 센서 전반에 걸친 폭넓은 제품 포트폴리오를 기반으로 전기차 및 하이브리드차의 에너지 변환 효율 제고, 배터리 관리, ADAS 기능 구현을 지원하며 시장 내 선도적 지위를 확보하고 있다. **Renesas Electronics(일본)**는 차량용 마이크로컨트롤러, 전력반도체, SoC 분야의 대표 공급업체로서 ADAS, 전동화, 커넥티비티 플랫폼에서 안정적인 제어와 성능 최적화를 지원한다. **Texas Instruments(미국)**는 아날로그 IC, 전력관리 솔루션, 임베디드 프로세서에 강점을 보유하고 있으며, 이를 통해 차량의 에너지 효율 개선과 인포테인먼트 및 안전 기능 고도화 관련 사업에 주력하고 있다.

한편, **Qualcomm(미국)**은 2020년 이후 차량용 반도체를 신성장 동력으로 삼고 관련 제품군을 확대하고 있다. 특히 IVI(In-Vehicle Infotainment) 분야에서는 전통 강자인 Renesas와 NXP를 앞서며 약 50% 수준의 글로벌 시장점유율로 1위 지위를 차지하고 있는 것으로 파악된다. 과거에는 IVI와 ADAS가 차급별로 별도 반도체로 구성되는 경우가 많았으나, 최근에는 두 기능을 통합하는 방향으로 시장이 재편되고 있어 Qualcomm의 영향력 확대 정도에 주목할 필요가 있다. Qualcomm의 자동차 사업부문 매출액은 2025년 회계연도 기준 40억 달러(약 5조 8,500억 원) 수준이며, 2029년에는 이를 80억 달러로 확대하겠다는 목표를 제시하고 있다. Qualcomm의 차량용 반도체 비중 확대는 국내 차량용 반도체 기업에는 부담 요인으로 작용할 수 있다. 국내 기업들은 상대적으로 기술적 진입장벽이 낮은 하위 모델

부터 단계적으로 국산화를 추진해왔으나, Qualcomm이 상위 플랫폼에서 하위 플랫폼으로 제품군을 확장하는 전략을 전개하면서 국내 차량용 반도체 기업들의 대응 부담이 커질 것으로 판단된다.

**글로벌 차량용 반도체 주요 기업 매출액 비교**




주: 2025년 회계연도 기준, 자료: 각 사, 한국IR협의회 기업리서치센터

## 2 글로벌 자율주행 산업 현황

**글로벌 자율주행 시장은 완전자율주행보다 ADAS 고도화 및 자율주행 레벨 2 대중화 중심으로 성장 기대**

글로벌 자율주행 산업은 완전자율주행의 급격한 확산보다는 ADAS 고도화와 자율주행 레벨 2 상용화 중심으로 기술 대중화가 단계적으로 이루어질 가능성이 높다. 현재 자율주행 산업의 핵심 기술은 카메라, 레이더, 라이다 등 여러 센서가 차량 주변 환경을 인지하고, 이를 AI 기반 소프트웨어가 실시간으로 해석하여 차량 내 각종 ECU와 제동·조향 시스템을 구동하는 체제이다.

특히 유럽연합(EU)은 개정 General Safety Regulation(GSR)에 따라 2024년 7월 7일부터 판매되는 모든 신차에 차선유지 및 자동긴급제동을 포함한 다양한 ADAS 기능 탑재를 의무화했다. 이러한 규제 강화는 차량당 센서·제어기·소프트웨어 탑재량을 높이는 직접적인 동인으로 작용하고 있다. 이에 따라 레벨 2 ADAS 탑재 차량은 2030년 전체 신차 판매의 52% 비중까지 확대될 것으로 전망되며, 도메인·존(Zonal)·중앙집중형 등 차세대 E/E 아키텍처의 적용 비중 역시 2035년 글로벌 신차 생산 기준 75%를 상회할 것으로 예상된다.

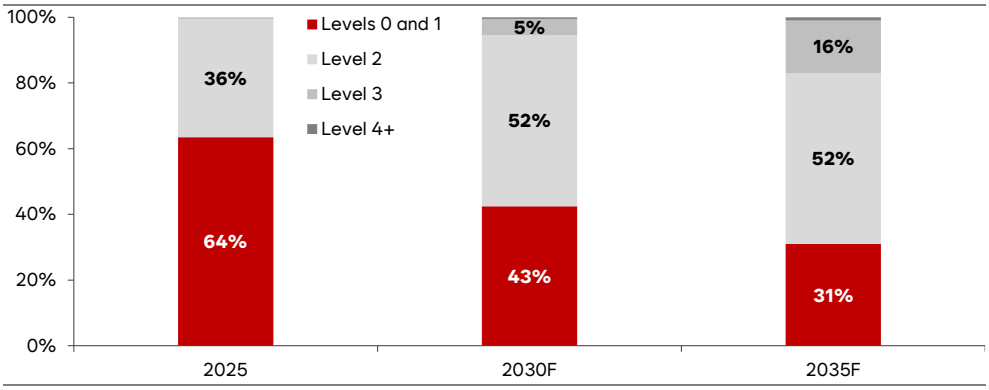
**자율주행 레벨 3는 2035년 16%까지 점진적으로 확산되는 반면, 레벨 4 이상은 기술·규제·안전 검증의 복합적 장벽으로 인해 동 시점 1% 수준에 그칠 전망**

자율주행 레벨 3는 향후 점진적인 상용화 확대가 예상되지만, 레벨 4 이상은 중장기적으로도 제한적인 영역에 머물 가능성이 높다. 컨설팅 및 시장조사기관 맥킨지(McKinsey)에 따르면, 글로벌 자율주행 레벨 3 차량의 판매 비중은 2025년 1% 미만에서 2035년 16%까지 확대될 것으로 전망되는 반면, 레벨 4 이상 차량의 비중은 2035년에도 1% 수준에 그칠 것으로 예상된다. 이는 기술 자체의 성능 고도화와 별개로, 실제 상용화 단계에서는 고신뢰성 검증, 기능안전 확보, 사이버보안 대응, 주행 데이터 기록·관리, 사고 발생 시 책임 구조 정립, 지역별 규제 및 인증 체계 정합성 확보 등 해결해야 할 제도적·기술적 과제가 여전히 산적해 있기 때문이다. 특히 레벨 4 이상은 운전자의 개입이 사실상 배제되는 구조인 만큼, 기술 완성도뿐 아니라 법적 책임 체계와 사회적 수용성까지 함께 담보되어야 해 상용화 속도가 더딜 수밖에 없다.

실제로 유럽연합(EU)은 레벨 4 무인차에 대해 별도의 입법을 통해 시험 절차, 사이버보안, 안전성 모니터링, 사고 보고 체계 등을 엄격히 요구하고 있으며, 레벨 3 역시 UN 규정과 연계된 별도 법제 틀 내에서 관리하고 있다. 이에 따라 글

로벌 자율주행 시장은 당분간 레벨 2 중심의 기술 보급 확대와 레벨 3의 점진적 확산 구도를 형성할 것으로 전망된다.

**글로벌 자율주행 단계별 점유율 전망**




자료: McKinsey & Company, 한국IR협의회 기업리서치센터

## 투자포인트

### 1 SoC 개발 용역 계약 체결 통한 실적 턴어라운드

**2025년 10월에 공시된 대형 SoC 개발 용역 계약은 실적 턴어라운드에 매우 긍정적**

2025년 10월에 공시된 대형 SoC 개발 용역 계약 체결은 실적 턴어라운드에 매우 긍정적이다. 동 계약은 2025.10 ~ 2028.01 기간 동안 진행될 예정으로, 총 772억 원 규모이다. 단, 아쉽게도 동 계약 관련해서는 고객과 비밀유지계약이 체결되어 고객명과 용도 등 제반 사항을 세부적으로 알기는 어렵다. 분기마다 약 80억 원대 매출로 반영될 SoC 개발 용역은 기존 내부 인력을 투입/활용 가능하고, 고부가 대규모 계약인 만큼 관련 마진은 높은 것으로 추정된다.

동 계약으로 인해 기타 매출액은 크게 증가세를 보이고 있다. 2026년 상반기 기타 매출은 354억 원을 기록, 전년 135억 원 대비 161.9% 성장했다. 전년 대비 기타 매출 증가 금액 중 70% 이상이 동 SoC 개발 용역 계약 때문인 것으로 보인다. 텔레칩스의 1H26 전사 매출액, 영업이익은 각각 1,253억 원, 93억 원을 기록했다. 전년 반기 대비 매출액은 358억 원 증가했고, 영업이익은 155억 원 급증하며 흑자로 전환하였다. 이러한 실적 턴어라운드 시현의 주 요인 중 하나가 SoC 개발 용역 매출 인식이라고 판단된다.

참고로, 텔레칩스 1H26 기준 지역별 매출액을 살펴보면, 한국 매출 351억 원, 일본 매출 329억 원, 중국 매출 112억 원, 기타 국가 매출 462억 원이었다. 1H25 당시를 살펴보면, 한국 매출 360억 원, 일본 매출 252억 원, 중국 매출 131억 원, 기타 국가 매출 152억 원이었다. 따라서 1H26부터 본격적으로 실적에 반영 중인 SoC 개발 용역은 정확한 고객은 알 수 없으나 지역적으로 볼 때 한국, 일본, 중국이 아닌 기타 국가 고객 또는 해당 지역 대응임을 알 수 있다.

### 2 지속적인 고객 다변화

**폭스바겐향 공급을 시작으로 일본·유럽·인도 등 글로벌 고객 다변화 진행 중. 특히 요구 스펙이 까다로운 일본 고객 납품 성과는 동사의 기술력을 대외적으로 입증한 레퍼런스**

2024년 4분기부터 텔레칩스 고객 다변화는 의미있게 진행되었다. 신규 대형 고객인 독일 폭스바겐향으로 TCC897x, 돌핀플러스 칩이 4Q24부터 공급되고 있다. 폭스바겐향 제품 공급은 텔레칩스 미래 성장의 한 축이라고 볼 수 있다. 돌핀플러스는 디지털 클러스터 內 HUD(Head Up Display)용 제품으로, 고객 호응도는 높다고 파악된다.

일본 고객도 확대되고 있다. 오토바이, 차량용 디지털 클러스터 칩을 2025년부터 단계적으로 납품 중이다. 일본 고객은 통상적으로 요구 스펙이 까다로운 편이다. 그럼에도 이렇게 일본 고객향 매출을 실현한 것은 제품력, 기술력 측면에서 텔레칩스가 대외적 인정을 업계에서 한단계 더 높이 받았음을 방증한다고 볼 수 있다.

이외에도 텔레칩스는 유럽, 인도의 유수 완성차/전장부품 기업들에게 각종 신제품을 프로모션하고 있어서 그 성과도 2027년부터 점차 가시화될 것으로 전망한다.

텔레칩스 돌핀플러스 칩 주요 특징

| | |
|---|---|
| 고성능 프로세서 | Arm Cortex-A72 쿼드 코어와 Cortex-A53 쿼드 코어 기반의 유연한 설계로 차량 콕핏, 클러스터 및 인포테인먼트 시스템에 적합 |
| 고성능 그래픽 | Imagination PowerVR series 9XTP 코어의 2D/3D 그래픽 엔진을 통해 생생한 GUI 제공, Hypervisor-Less Cockpit(HLC) 솔루션을 위한 하드웨어 가상화 지원 |
| 다양한 멀티미디어 및 안전 기능 | 멀티 디스플레이와 멀티 채널 카메라 입력 지원, 이미지 신호 처리 서브 시스템 및 독립 안전 영역을 지원하는 MICOM 서브 시스템 포함 |

자료: 텔레칩스, 한국IR협의회 기업리서치센터

**고가 시장 퀄컴, 중저가 시장 미디어텍 양강 구도의 글로벌 차량용 비메모리 반도체 시장 내 텔레칩스는 고가부터 중저가까지 전 가격대를 아우르는 맞춤형 제품 라인업으로 차별화 가능**

글로벌 차량용 비메모리 칩 시장은 고가와 중저가 시장이 나뉘어 있고 고가 시장에서는 미국 퀄컴이, 중저가 시장에서는 대만 미디어텍이 강자이다. 완성차 및 전장부품 기업 입장에서는 칩 제품력이 뛰어나더라도 1개의 공급사에게만 제품을 납품받기에는 리스크가 존재하기에 다변화된 공급사 체계를 선호한다. 특정 부품에 대해 단독 납품 체제를 가져가면 천재지변 등에 의한 공급 차질/제약 가능성이나 가격 협상 불리함 등을 감수해야 하기 때문이다. 완성차/전장부품 업체들은 퀄컴, 미디어텍 뿐만 아니라 기술력이 높으면서도 가격 경쟁력이 있는 칩 공급사를 원하고 있다.

이러한 고객 니즈를 만족시키는 칩 공급사 중 하나가 텔레칩스 라고 볼 수 있다. 텔레칩스는 고가와 중저가 시장 모두를 차별화, 맞춤화 제품으로 공략하고 있다. 고객은 최고 사양의 값비싼 칩 만을 원하지는 않는다. 완성차도 저가에서 중가, 고가 라인업이 있기에 그에 맞는 적절한 칩 소싱을 원한다. 텔레칩스는 고객의 다양한 요구 스펙을 맞출 수 있는 비메모리 반도체 강소기업이다. 2027년 이후부터 텔레칩스는 인도, 아시아 지역 완성차/전장부품 기업들을 대상으로 중저가 및 일부 중고가 사양 칩을 공급할 수 있을 것으로 기대한다.

# 실적 추이 및 전망

## 1 2025년 연간 실적 Review

**2025년 매출액 1928억 원, 영업이익 -62억 원 기록**

2025년 연간 연결 기준 매출액, 영업이익은 각각 1,928억 원, -62억 원이었다.

연간 매출액은 전년(1,866억 원) 대비 3.3% 성장한 1,928억 원을 기록했다. 기존 주 고객 내 점유율이 하락했으나 해외 고객 및 신규 고객 확보 효과로 이를 상쇄했다. 4Q24부터 시작된 폭스바겐향 공급이 매출 측면에서 긍정적이었고, 4Q25부터 시작된 SoC 용역 매출(4분기 82억 원 발생)도 매출 성장에 기여했다. 제품 측면에서는 TCC897x, 돌핀플러스 등 중저가 제품들이 연매출액의 60% 이상 비중을 보인 것으로 파악된다.

부문별로 살펴보면, DMP 매출은 2024년 1,586억 원에서 2025년 1,549억 원으로 37억 원 감소했고, 모바일TV 수신칩 매출은 2024년 30억 원에서 2025 12억 원으로 18억 원 감소했다. 반면, 기타 매출은 2024년 250억 원에서 2025년 367억 원으로 117억 원 증가했다.

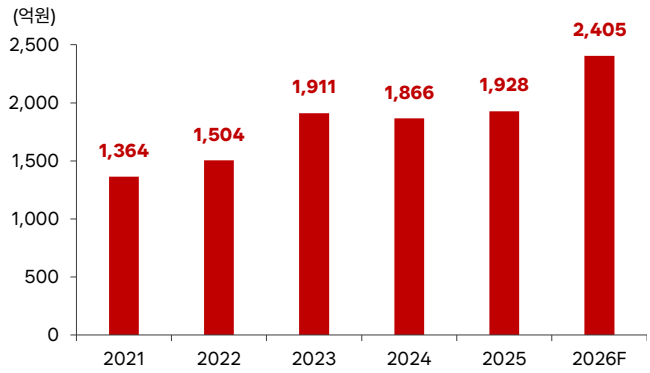
**주 고객 내 경쟁심화, 인건비 부담으로 영업이익 적자전환**

연간 영업이익은 전년(49억 원) 대비 크게 악화되어 -62억 원으로 적자전환했다. 전년 대비 매출액이 소폭 성장했음에도 주 고객 내 경쟁심화로 상대적으로 마진이 좋은 고부가 칩 매출이 감소했고, 연구개발을 위한 인력 확대로 인건비 부담이 가중되며 영업이익이 부진했다.

참고로 사업보고서 상 비용의 성격별 분류에서 주요 비용 증가 요인을 살펴보면 아래와 같았다. 원재료 및 소모품비 항목이 2024년 627억 원에서 2025년 646억 원으로 19억 원 증가했고, 종업원급여 항목이 2024년 464억 원에서 2025년 504억 원으로 40억 원 증가했으며, 외주용역비 항목이 2024년 316억 원에서 2025년 359억 원으로 43억 원 증가했고, 기타 비용이 2024년 373억 원에서 2025년 409억 원으로 36억 원 증가했다.

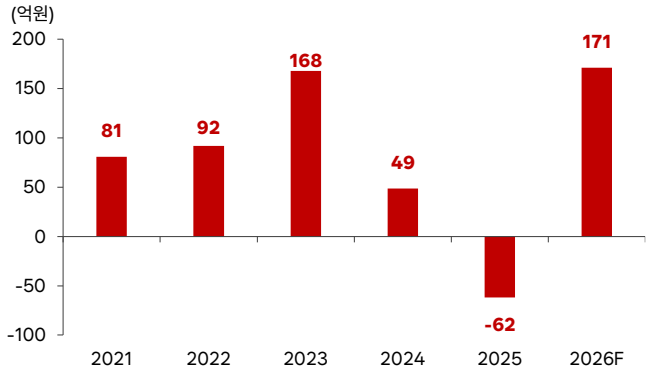
연간 순이익은 전년(-386억 원) 대비 크게 악화된 -616억 원이었다. 이는 영업외 수지에서 대량의 손실을 반영했기 때문이었다. 영업외비용 상 기타손실 650억 원이 발생했는데, 이는 크게 2가지 요인 때문이었다. 동사는 개발비 무형자산 손상차손으로 449억 원을, 잡손실(소송 합의금 위주)로 163억 원을 손실로 반영했다.

연간 연결 기준 매출액 추이 및 전망




자료: 텔레칩스, 한국IR협의회 기업리서치센터

연간 연결 기준 영업이익 추이 및 전망




자료: 텔레칩스, 한국IR협의회 기업리서치센터

## 2 2026F 실적 전망

**1H26 영업이익은 93억 원을 기록하며 전년 대비 흑자전환**

1H26 매출액, 영업이익은 각각 1,253억 원, 93억 원을 기록했다. 전년 반기 실적 대비해서 매출액은 358억 원 증가했고, 영업이익은 흑자전환 했다. 전년 반기 매출액, 영업이익은 각각 895억 원, -62억 원이었다. 국내 주 고객향 물량 감소가 어느정도 진행된 이후 해외 고객 물량 증가와 신규 고객 확보 효과가 견조했다. 부문별로 보면 DMP 매출은 1H25 756억 원에서 1H26 888억 원으로 132억 원 증가했고, 모바일TV 수신칩 매출은 1H25 4억 원에서 1H26 11억 원으로 7억 원 증가했고, 기타 매출은 1H25 135억 원에서 1H26 354억 원으로 219억 원 증가했다. 즉 DMP 매출이 견조하게 증가하는 가운데, 기타 매출 내 SoC 개발 용역 매출이 동사 성장에 크게 기여했다.

2026년 상반기 영업이익은 93억 원으로 전년 -62억 원 대비 흑자로 전환되었다. 매출 증가로 인한 고정비 부담 완화와 고부가 매출인 SoC 개발 용역 매출 확대가 수익성에 긍정적으로 작용했다. 상반기 영업이익률은 7.4%를 기록하여 전년 반기 -6.9% 대비 대폭 개선되었다.
참고로, 1H26 매출원가율은 61.4%로 전년 반기 61.7% 대비 유사한 수준이었다. 그러나 1H26 판관비율은 31.1%로 전년 반기 45.2% 대비 14.1%p 개선되는 모습을 보였다. 절대금액으로 판관비는 1H26 390억 원을 기록, 1H25 405억 원에서 15억 원 감소했다. 경상연구개발비가 전년 대비 25억 원 감소한 것이 주효했다.

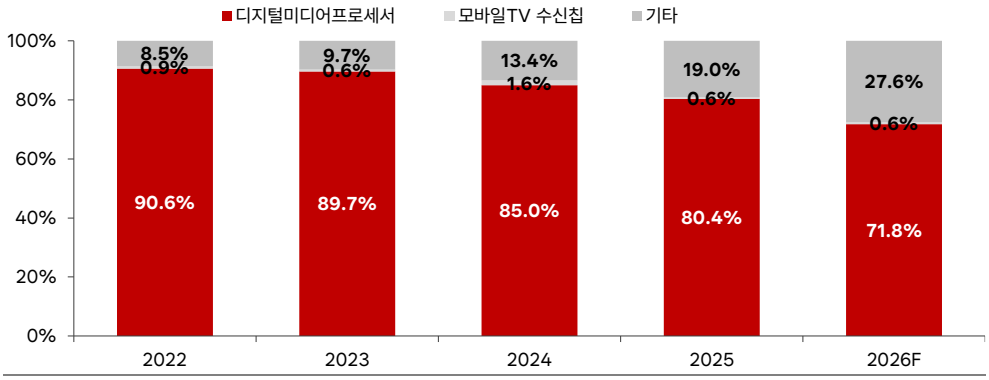
반기 순이익은 전년(-67억 원) 대비 개선된 -32억 원이었다. 한편 당 반기에 영업외 수지에 계상된 특이사항은 다음과 같았다. 당 반기 금융원가가 148억 원 발생했는데(금융자산 평가손실 100억 원, 파생상품 평가손실 40억 원 등), 이는 보유한 코스닥 상장사 칩스앤미디어 지분 관련 평가손실 반영 때문이었다. 참고로 동사는 칩스앤미디어를 2022년 한국투자파트너스에 매각하였지만 지분 7.22%는 당시 계약에 의거하여 보유 중이다.

**2026년 연간 연결 기준 매출액, 영업이익은 각각 2,405억 원(+24.7% YoY), 171억 원(흑자전환 YoY) 기대**

2026년 연간 매출액은 전년 대비 24.7% 성장한 2,405억 원으로 전망된다.
폭스바겐 및 일본, 일부 유럽 고객향 수요가 견조하고, 현대차그룹향의 경우 해외 관련 수요가 양호할 것으로 기대된다. 연간 부문별 매출 비중으로 DMP 71.8%, 모바일TV 수신칩 0.6%, 기타 27.6%를 전망한다. 4Q25부터 시작된 SoC 개발 용역 건(25.10.10 공시)으로 인해 2026~2027년 기간에는 기타 매출 비중이 증가할 전망인 점(당분간 분기당 80억 원 이상 관련 매출액 반영 예상)을 매출액 추정 시 고려했다.

2026년 연간 영업이익은 171억 원으로, 전년(-62억 원) 대비 흑자로 전환될 것으로 전망한다. 이미 상반기 영업이익이 93억 원을 기록, 동 추정에는 무리가 없다고 보인다. 매출 규모 확보와 제품믹스 개선 효과, 일부 판관비 감소 효과가 하반기에 이어질 전망이다.
2027년 이후에는 인도, 아시아 지역 중심으로 신규 고객 확대, 점진적인 고부가 제품 비중 상승 등을 기대할 수 있을 전망이다. 또한 2027년경부터는 자율주행 산업의 고도화, 글로벌 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)의 완화로 전기차/스마트카 관련 수요 개선 효과도 기대한다.

부문별 연도별 매출 비중 추이 및 전망




자료: 텔레칩스, 한국IR협의회 기업리서치센터

실적 추이 및 전망 (단위: 억 원)

| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026F |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,504 | 1,911 | 1,866 | 1,928 | **2,405** |
| ① 디지털미디어프로세서 | 1,362 | 1,713 | 1,586 | 1,549 | **1,727** |
| ② 모바일 TV 수신칩 | 14 | 12 | 30 | 12 | **14** |
| ③ 기타 | 128 | 185 | 250 | 367 | **664** |
| 영업이익 | 92 | 168 | 49 | -62 | **171** |
| 지배주주순이익 | 459 | 626 | -386 | -616 | **58** |
| YoY 증감률 | | | | | |
| 매출액 | 10.3 | 27.1 | -2.3 | 3.3 | **24.7** |
| 영업이익 | 13.7 | 82.8 | -70.9 | 적전 | **흑전** |
| 지배주주순이익 | 552.7 | 36.5 | 적전 | 적지 | **흑전** |
| 영업이익률 | 6.1 | 8.8 | 2.6 | -3.2 | **7.1** |
| 지배주주순이익률 | 30.5 | 32.8 | -20.7 | -32.0 | **2.4** |

자료: 텔레칩스, 한국IR협의회 기업리서치센터

## Valuation

### 2026년 PSR 0.4배로 거래 중

**2026F 동사 PSR 밸류에이션은 코스닥 시장 대비 낮음**

2026년 11월 9일 기준 텔레칩스 시가총액은 1,069억 원 수준이다. 2026년 텔레칩스의 예상 PSR은 0.4배 정도로, 코스닥 시장(1.4배) 대비 할인되어 거래되고 있다.

**Peer로 LX세미콘, 어보브반도체 선정**

텔레칩스는 차량용 비메모리 반도체 제조/판매 전문기업이다. 동사와 유사한 상장 기업은 LX세미콘, 어보브반도체 등을 고려할 수 있다. 동사의 Peer로 LX세미콘, 어보브반도체를 선정하여 아래 표와 같이 동사와 밸류에이션을 비교해 보았다. Peer 기업의 시장 컨센서스 수치가 부재하여 멀티플 비교는 PSR TTM(Trailing Twelve Months)을 적용, 비교했다. PSR(TTM)은 현재 주가를 최근 4개 분기 합산 SPS(주당매출액)로 나누어 구하며, 향후 실적 컨센서스가 없는 기업도 이미 확정된 실적과 현재 주가를 기준으로 비교할 수 있다.

**PSR(TTM) 기준 Peer 대비 할증**

2026년 11월 9일 기준 비교 3개사의 PSR(TTM) 밸류에이션은 다음과 같다(동사 0.47배 VS LX세미콘 0.24배 VS 어보브반도체 0.41배). 동사는 LX세미콘, 어보브반도체 대비해서 상대적으로 PSR(TTM) 할증을 받고 있다.

**Peer 대비 높은 성장성과 수익성이 멀티플 할증 이유**

**LX세미콘**은 디스플레이 구동칩(DDI)을 주력으로 하는 팹리스 기업이다. 1H26 매출액은 7,899억 원(-7.6% YoY), 영업이익은 426억 원(-39.1% YoY, 영업이익률 5.4%)으로 감소했고, 3Q26에는 매출액 3,360억 원(-14.8% YoY), 영업손실 156억 원으로 적자전환했다. 전방 수요 부진과 메모리 가격 상승에 따른 부품 가격 인하 압력 등이 실적부진 원인으로 지목된다. 8월 차량용 MCU 양산·공급을 시작했으나 신사업이 본업 부진을 상쇄하기에는 아직 규모가 작아 Discount를 해소하지 못하고 있는 상황으로 보인다.

**어보브반도체**는 가전용 마이크로컨트롤러(MCU) 전문기업이다. 1H26 연결 기준 매출액은 1,314억 원(+7.1% YoY)으로 증가했으나 영업이익은 67억 원(-8.0% YoY, 영업이익률 5.1%)으로 감소했다. 연결 기준 매출 증가는 후공정 자회사 윈팩의 매출 확대(524억 원, +59.0% YoY)에 기인했는데, 윈팩은 영업손실 13억 원으로 전년 동기(-83억 원) 대비 적자 폭을 줄였으나 흑자전환에는 이르지 못했다. 여기에 MCU 부문 영업이익이 79억 원(-49.2% YoY)으로 감소하며 연결 영업이익이 줄었다. 28나노 고성능 MCU 출시, AI MCU 상용화 등 제품 고도화 노력이 진행 중이나, 아직 실적 기여도는 제한적인 것으로 파악된다.

동사는 1H26 매출액 1,253억 원(+40.0% YoY), 영업이익 93억 원(흑자전환, 영업이익률 7.4%)으로 비교 3개사 중 가장 높은 매출 성장률과 영업이익률을 기록했다. 해외 고객 물량 증가와 신규 고객 확보로 DMP 매출이 132억 원 증가했고, 고부가 매출인 SoC 개발 용역 매출이 확대되며 수익성이 크게 개선되었다. Peer 대비 PSR(TTM) 할증은 이러한 실적 턴어라운드가 반영된 결과로 판단된다.

동종 업종 밸류에이션

| 기업명 | 종가 (원, 달러) | 시가총액 (십억원,백만달러) | 매출액(십억원,백만달러) | | | PSR(배) | | | PBR(배) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026F | 2024 | 2025 | 2026F | 2024 | 2025 | 2026F |
| 코스피 | 5,019 | 4,000,297 | 3,713,280 | 3,919,857 | 4,156,236 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.2 |
| 코스닥 | 639 | 363,677 | 332,962 | 361,554 | 141,187 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.0 |
| **텔레칩스** | **7,060** | **107** | **187** | **193** | **241** | **1.0** | **1.3** | **0.4** | **1.0** | **1.7** | **0.7** |
| LX세미콘 | 22,850 | 372 | 1,866 | 1,639 | - | 0.5 | 0.5 | - | 0.9 | 0.7 | - |
| 어보브반도체 | 5,820 | 103 | 232 | 244 | - | 0.6 | 0.9 | - | 1.1 | 1.7 | - |
| **동종업종 평균** | | | | | | **0.5** | **0.7** | **-** | **1.0** | **1.2** | **-** |

주: 2026년 11월 09일 종가 기준, 자료: FnGuide QuantiWise, Refinitiv, 한국IR협의회 기업리서치센터

**1H26 실적 턴어라운드에도 2026년 주가는 연초 대비 크게 하락**

텔레칩스 주가는 2025년 12월 한 달간 30.1% 상승하며 15,980원으로 연말을 마감했다. 2025년 10월 체결한 SoC 개발 용역 계약(772억 원 규모) 관련 매출이 4Q25부터 반영되기 시작했고, 12월에는 신제품 돌핀5 칩셋이 구글 'Android 15 VSR 프로그램' 승인을 획득하는 등 실적 턴어라운드와 신제품 기대가 동시에 부각되었다. 그러나 2026년 1~3월에는 주가가 약세로 돌아섰다. 2월 발표된 2025년 연간 실적에서 영업이익이 -62억 원으로 적자전환하고, 당기순손실이 -616억 원으로 확대된 점이 부담으로 작용했다. 3월에는 미국-이란 전쟁 발발에 따른 국내 증시 급락 영향까지 겹쳤다. 이후 주가는 1Q26 매출액 661억 원(+46.2% YoY), 영업이익 61억 원(흑자전환)의 호실적을 계기로 반등했고, 5월 코스피가 7,000선과 8,000선을 돌파하는 등 증시 전반 강세가 더해지며 연중 최고 18,450원을 기록했다. 6월 이후 국내 증시에서 반도체주 중심으로 변동성이 커지며 시장이 급락하는 흐름 속에 동사 주가도 하락했다. 7월에는 미국-이란 교전 재개 등으로 증시 약세가 이어지며 7월 29일 기준 7,370원을 기록했다. 8월 발표된 1H26 실적은 영업이익이 93억 원으로 흑자전환했으나, 보유 중인 칩스앤미디어 지분 관련 평가손실 등 금융원가 148억 원이 반영되며 반기순손실은 32억 원을 기록했다. 이후 주가는 9천~1만 원대에서 횡보하다 10월 국내 증시 급락과 함께 재차 하락했으며, 11월 9일 종가는 7,060원으로 2025년말 대비 55.8% 낮은 수준이다.

동사의 현재 주가는 2026F PSR 0.4배로 코스닥(1.4배) 대비 크게 할인되어 있다. 상반기 영업이익이 이미 93억 원을 기록하여 2026년 연간 영업이익 흑자전환 가시성은 높다. 2027년 이후 인도·아시아 지역 신규 고객 확대와 고부가 제품 비중 상승 등이 확인되며 향후 추가적인 멀티플 개선이 가능할 것으로 기대한다.

텔레칩스 주가 추이




자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

## 리스크 요인

### 1 자동차 산업의 SDV, 자율주행 전환이 기대보다 늦어질 가능성

**전세계적으로 SDV, 자율주행 전환 속도가 기대를 하회한다면 차량용 반도체 기업 실적에는 부정적일 수 있어**

글로벌 자동차 산업에서 SDV(Software Defined Vehicle, 소프트웨어 중심 차량), 자율주행 전환이 시장 기대를 하회하며 늦어진다면 고부가 자동차 칩의 개발과 탑재 니즈가 감소할 수 있고, 이는 텔레칩스와 같은 차량용 반도체 기업 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있다.

참고로 자율주행 산업은 글로벌 Top 2인 웨이모, 테슬라가 주도하며 꾸준히 발전하고 있다. 현대차그룹의 경우도 2026년 연말경 로보택시 서비스를 미국에서 상용화할 전망이다. 현대차그룹 계열사 모셔널은 현재 자율주행 테스트를 미국 라스베이거스, 피츠버그에서 진행 중이다. 모셔널은 두 도시가 도로 환경이 상이하여 데이터 수집 시 퀄러티가 좋아 이를 활용, 향후 전세계 다양한 도시에서 자율주행 서비스를 상용화할 예정임을 피력했다.

현대차그룹은 상대적으로 뒤쳐진 SDV/자율주행 기술력을 끌어올리기 위해 다양한 노력을 진행하고 있다. 그 대표적인 예는 엔비디아 출신의 박민우 현대차 AVP(첨단차량플랫폼) 본부장 겸 포티투닷 대표이사 영입이다. 박민우 대표이사는 테슬라, 엔비디아 등 글로벌 기업에서 컴퓨터 비전 기반 자율주행 분야 기술의 연구/개발, 양산, 상용화 등 전 과정을 경험했으며, 송창현 전 포티투닷 대표이사가 퇴임 의사를 밝히면서 2026년 2월 최연소 신임 사장으로 현대차그룹에 영입되었다. 현대차그룹의 SDV, 자율주행 전환 속도가 빨라져 관련 생태계에 활력이 돌지 향후 예의주시할 필요가 있다.

## 포괄손익계산서

| (억원) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026F |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,504 | 1,911 | 1,866 | 1,928 | 2,405 |
| 증가율(%) | 10.3 | 27.1 | -2.3 | 3.3 | 24.7 |
| 매출원가 | 938 | 1,106 | 1,061 | 1,186 | 1,450 |
| 매출원가율(%) | 62.4 | 57.9 | 56.9 | 61.5 | 60.3 |
| 매출총이익 | 566 | 804 | 805 | 742 | 955 |
| 매출이익률(%) | 37.6 | 42.1 | 43.1 | 38.5 | 39.7 |
| 판매관리비 | 474 | 637 | 756 | 804 | 784 |
| 판관비율(%) | 31.5 | 33.3 | 40.5 | 41.7 | 32.6 |
| EBITDA | 220 | 289 | 150 | 32 | 272 |
| EBITDA 이익률(%) | 14.7 | 15.1 | 8.1 | 1.6 | 11.3 |
| 증가율(%) | 16.2 | 31.3 | -48.1 | -78.9 | 758.3 |
| 영업이익 | 92 | 168 | 49 | -62 | 171 |
| 영업이익률(%) | 6.1 | 8.8 | 2.6 | -3.2 | 7.1 |
| 증가율(%) | 13.7 | 82.8 | -70.9 | 적전 | 흑전 |
| 영업외손익 | -58 | 501 | -411 | -554 | -108 |
| 금융수익 | 19 | 523 | 19 | 84 | 30 |
| 금융비용 | 71 | 36 | 364 | 34 | 165 |
| 기타영업외손익 | -7 | 14 | -65 | -604 | 27 |
| 종속/관계기업관련손익 | 444 | -22 | -4 | -4 | -3 |
| 세전계속사업이익 | 478 | 647 | -367 | -620 | 60 |
| 증가율(%) | 502.6 | 35.3 | 적전 | 적지 | 흑전 |
| 법인세비용 | 19 | 20 | 19 | -3 | 2 |
| 계속사업이익 | 459 | 626 | -386 | -616 | 58 |
| 중단사업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기순이익 | 459 | 626 | -386 | -616 | 58 |
| 당기순이익률(%) | 30.5 | 32.8 | -20.7 | -32.0 | 2.4 |
| 증가율(%) | 552.7 | 36.5 | 적전 | 적지 | 흑전 |
| 지배주주지분 순이익 | 459 | 626 | -386 | -616 | 58 |

## 재무상태표

| (억원) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026F |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 1,197 | 1,624 | 1,398 | 1,362 | 1,354 |
| 현금성자산 | 121 | 162 | 300 | 232 | 435 |
| 단기투자자산 | 486 | 832 | 450 | 278 | 190 |
| 매출채권 | 141 | 153 | 146 | 365 | 262 |
| 재고자산 | 315 | 331 | 367 | 361 | 310 |
| 기타유동자산 | 134 | 146 | 135 | 126 | 157 |
| 비유동자산 | 1,904 | 2,124 | 2,381 | 2,313 | 2,603 |
| 유형자산 | 698 | 691 | 673 | 638 | 624 |
| 무형자산 | 746 | 920 | 1,229 | 1,109 | 1,412 |
| 투자자산 | 44 | 89 | 126 | 99 | 100 |
| 기타비유동자산 | 416 | 424 | 353 | 467 | 467 |
| 자산총계 | 3,102 | 3,748 | 3,779 | 3,675 | 3,957 |
| 유동부채 | 1,020 | 664 | 1,124 | 1,398 | 1,477 |
| 단기차입금 | 300 | 300 | 500 | 610 | 750 |
| 매입채무 | 109 | 133 | 158 | 0 | 0 |
| 기타유동부채 | 611 | 231 | 466 | 788 | 727 |
| 비유동부채 | 385 | 622 | 637 | 848 | 997 |
| 사채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기차입금 | 314 | 530 | 505 | 668 | 775 |
| 기타비유동부채 | 71 | 92 | 132 | 180 | 222 |
| 부채총계 | 1,405 | 1,286 | 1,761 | 2,246 | 2,474 |
| 지배주주지분 | 1,697 | 2,462 | 2,017 | 1,430 | 1,483 |
| 자본금 | 69 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 자본잉여금 | 360 | 564 | 564 | 564 | 564 |
| 자본조정 등 | -11 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 기타포괄이익누계액 | -5 | -3 | 12 | 31 | 31 |
| 이익잉여금 | 1,284 | 1,876 | 1,416 | 809 | 862 |
| 자본총계 | 1,697 | 2,462 | 2,017 | 1,430 | 1,483 |

## 현금흐름표

| (억원) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026F |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | -73 | 78 | 57 | -91 | 203 |
| 당기순이익 | 459 | 626 | -386 | -616 | 58 |
| 유형자산 상각비 | 39 | 55 | 59 | 58 | 59 |
| 무형자산 상각비 | 90 | 67 | 43 | 36 | 42 |
| 외환손익 | 5 | 3 | 4 | 15 | 0 |
| 운전자본의감소(증가) | -267 | -123 | -58 | 97 | 96 |
| 기타 | -399 | -550 | 395 | 319 | -52 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -634 | -288 | -422 | -167 | -251 |
| 투자자산의 감소(증가) | 502 | -32 | -20 | -12 | -1 |
| 유형자산의 감소 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 유형자산의 증가(CAPEX) | -520 | -107 | -14 | -17 | -45 |
| 기타 | -616 | -149 | -388 | -139 | -205 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | 630 | 251 | 500 | 195 | 251 |
| 차입금의 증가(감소) | 300 | 216 | 416 | 66 | 251 |
| 사채의증가(감소) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본의 증가 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 배당금 | -15 | -18 | -30 | -9 | 0 |
| 기타 | 283 | 53 | 114 | 138 | 0 |
| 기타현금흐름 | -1 | -0 | 3 | -5 | 0 |
| 현금의증가(감소) | -77 | 40 | 138 | -68 | 203 |
| 기초현금 | 199 | 121 | 162 | 300 | 232 |
| 기말현금 | 121 | 162 | 300 | 232 | 435 |

## 주요투자지표

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026F |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E(배) | 3.3 | 7.7 | N/A | N/A | 18.4 |
| P/B(배) | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 0.7 |
| P/S(배) | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 0.4 |
| EV/EBITDA(배) | 8.1 | 16.9 | 16.3 | 102.3 | 7.5 |
| 배당수익률(%) | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.4 |
| EPS(원) | 3,349 | 4,297 | -2,546 | -4,070 | 383 |
| BPS(원) | 12,245 | 16,257 | 13,321 | 9,441 | 9,795 |
| SPS(원) | 10,976 | 13,109 | 12,323 | 12,731 | 15,881 |
| DPS(원) | 130 | 200 | 60 | 0 | 30 |
| 수익성(%) | | | | | |
| ROE | 33.3 | 30.1 | -17.2 | -35.8 | 4.0 |
| ROA | 17.7 | 18.3 | -10.2 | -16.5 | 1.5 |
| ROIC | 5.8 | 9.1 | 2.8 | -3.0 | 8.2 |
| 안정성(%) | | | | | |
| 유동비율 | 117.4 | 244.5 | 124.3 | 97.5 | 91.7 |
| 부채비율 | 82.8 | 52.2 | 87.3 | 157.1 | 166.8 |
| 순차입금비율 | 14.5 | -6.5 | 26.3 | 57.7 | 64.8 |
| 이자보상배율 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | -6.1 | 15.0 |
| 활동성(%) | | | | | |
| 총자산회전율 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 매출채권회전율 | 10.4 | 13.0 | 12.5 | 7.6 | 7.7 |
| 재고자산회전율 | 5.1 | 5.9 | 5.4 | 5.3 | 7.2 |

## 최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

**시장경보제도란?**

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다. 시장경보제도는 '투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목'의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.

※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7

| 종목명 | 투자주의종목 | 투자경고종목 | 투자위험종목 |
|---|---|---|---|
| 텔레칩스 | X | X | X |

## 발간 History

| 발간일 | 제목 |
|---|---|
| 2026.11.11 | 텔레칩스-다시 뛰는 차량용 반도체 전문기업 |
| 2024.11.22 | 텔레칩스-고객 다변화가 기대되는 비메모리 반도체 토종 기업 |
| 2023.08.01 | 텔레칩스-반짝반짝 빛이나는 비메모리 반도체 토종 강자 |

## Compliance notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다.

- 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 중소형 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나
- 완벽성은 보장하지 않습니다.
- 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 텔레그램에서 "한국IR협의회(https://t.me/kirsofficial)" 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받으실 수 있습니다.
- 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 'IRTV'에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 '小中한탐방'과 2) 기업보고서 심층해설방송인 '小中한 리포트 가치보기'를 보실 수 있습니다.